

2020-2026年中国集成电路 封装行业前景展望与投资战略研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国集成电路封装行业前景展望与投资战略研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202005/162976.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

报告目录：

第1章：中国集成电路封装行业发展背景

1.1 集成电路封装行业定义及分类

1.1.1 集成电路封装界定

- (1) 集成电路封装产业概念
- (2) 集成电路封装产业链位置
- (3) 集成电路封装作用

1.1.2 集成电路封装行业产品分类

- (1) 按功能分类
- (2) 按集成度分类
- (3) 按封装外形分类

1.1.3 集成电路封装行业特性分析

- (1) 行业周期性失灵
- (2) 行业区域性
- (3) 行业季节性

1.2 集成电路封装行业政策环境分析

1.2.1 行业管理体制

1.2.2 行业相关政策

1.3 集成电路封装行业经济环境分析

1.3.1 国际宏观经济环境及影响分析

- (1) 国际宏观经济现状
- (2) 国际宏观经济展望
- (3) 国际宏观经济环境对行业影响分析

1.3.2 国内宏观经济环境及影响分析

- (1) 中国GDP及增长情况分析
- (2) 中国工业经济增长分析
- (3) GDP与集成电路封装行业的关联性分析
- (4) 居民收入水平

1.3.3 居民收入与行业的相关性

1.4 集成电路封装行业技术环境分析

- 1.4.1 集成电路封装技术演进分析
- 1.4.2 集成电路封装形式应用领域
- 1.4.3 集成电路封装工艺流程分析
- 1.4.4 集成电路封装行业新技术动态

第2章：中国集成电路产业发展分析

2.1 集成电路产业发展状况

2.1.1 集成电路产业简介

2.1.2 集成电路产业发展现状

2.1.3 集成电路产业运营情况

2.1.4 集成电路产业三大区域分析

- (1) 集成电路产业分布特征
- (2) 集成电路产业布局发展趋势
- (3) 未来集成电路产业空间布局

2.1.5 集成电路产业面临挑战、发展途径以及发展前景

- (1) 集成电路产业当下存在问题
- (2) 集成电路产业“十三五”面临挑战
- (3) 集成电路产业“十三五”发展途径
- (4) 集成电路产业发展前景

2.1.6 集成电路产业发展预测

- (1) 战略性新兴产业将加速发展
- (2) 资本市场将为企业融资提供更多机会

2.2 集成电路设计业发展状况

2.2.1 集成电路设计业发展概况

2.2.2 集成电路设计业行业发展现状

- (1) 产业规模持续扩大
- (2) 产业结构调整加速
- (3) 企业规模加速发展
- (4) 技术能力大幅提升

2.2.3 集成电路设计业行业政策分析

2.2.4 集成电路设计业发展策略分析

2.2.5 集成电路设计业“十三五”发展预测

- (1) 产业规模
- (2) 企业建设
- (3) 技术水平

2.3 集成电路制造业发展状况

2.3.1 集成电路制造业发展现状分析

- (1) 集成电路制造业发展总体概况
- (2) 集成电路制造业发展主要特点

2.3.2 集成电路制造行业规模及财务指标分析

- (1) 集成电路制造行业规模分析
- (2) 集成电路制造行业盈利能力分析
- (3) 集成电路制造行业运营能力分析
- (4) 集成电路制造行业偿债能力分析
- (5) 集成电路制造行业发展能力分析

2.3.3 集成电路制造行业供需平衡分析

- (1) 集成电路制造行业供给情况分析
- (2) 集成电路制造行业需求情况分析
- (3) 全国集成电路制造行业产销率分析

2.3.4 集成电路制造业“十三五”发展预测

第3章：中国集成电路封装行业发展分析

3.1 中国集成电路封装行业发展历程

3.2 中国集成电路封装行业发展现状

3.2.1 集成电路封装行业规模分析

3.2.2 集成电路封装行业发展现状分析

3.2.3 集成电路封装行业利润水平分析

3.2.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较

3.2.5 集成电路封装行业影响因素分析

- (1) 有利因素
- (2) 不利因素

3.2.6 集成电路封装行业发展趋势及前景预测

- (1) 发展趋势分析
- (2) 前景预测

3.3 半导体封测发展情况分析

3.3.1 半导体行业发展概况

3.3.2 半导体行业景气预测

3.3.3 半导体封装发展分析

- (1) 封装环节产值逐年成长
- (2) 封装环节外包是未来发展趋势

3.4 集成电路封装类专利分析

3.4.1 专利分析样本构成

- (1) 数据库选择
- (2) 检索方式

3.4.2 专利发展情况分析

- (1) 专利申请数量趋势
- (2) 专利公开数量趋势
- (3) 技术分类趋势分布
- (4) 主要权利人分布情况

3.5 集成电路封装过程部分技术问题探讨

3.5.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策

- (1) 封装开裂的影响因素分析
- (2) 管控影响开裂的因素的方法分析

3.5.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策

- (1) 产生芯片弹坑问题的因素分析
- (2) 预防芯片弹坑问题产生的方法

第4章：中国集成电路封装市场产品及需求分析

4.1 集成电路封装行业主要产品分析

4.1.1 BGA产品市场分析

- (1) BGA封装技术
- (2) BGA产品主要应用领域
- (3) BGA产品需求拉动因素
- (4) BGA产品市场应用现状分析
- (5) BGA产品市场前景展望

4.1.2 SIP产品市场分析

- (1) SIP封装技术
- (2) SIP产品主要应用领域
- (3) SIP产品需求拉动因素
- (4) SIP产品市场应用现状分析
- (5) SIP产品市场前景展望

4.1.3 SOP产品市场分析

- (1) SOP封装技术
- (2) SOP产品主要应用领域
- (3) SOP产品市场发展现状
- (4) SOP产品市场前景展望

4.1.4 QFP产品市场分析

- (1) QFP封装技术
- (2) QFP产品主要应用领域
- (3) QFP产品市场发展现状
- (4) QFP产品市场前景展望

4.1.5 QFN产品市场分析

- (1) QFN封装技术
- (2) QFN产品主要应用领域
- (3) QFN产品市场发展现状
- (4) QFN产品市场前景展望

4.1.6 MCM产品市场分析

- (1) MCM封装技术水平概况
- (2) MCM产品主要应用领域
- (3) MCM产品需求拉动因素
- (4) MCM产品市场发展现状
- (5) MCM产品市场前景展望

4.1.7 CSP产品市场分析

- (1) CSP封装技术水平概况
- (2) CSP产品主要应用领域
- (3) CSP产品市场发展现状
- (4) CSP产品市场前景展望

4.1.8 其他产品市场分析

- (1) 晶圆级封装市场分析
- (2) 覆晶/倒封装市场分析
- (3) 3D封装市场分析
- 4.2 集成电路封装行业市场需求分析
 - 4.2.1 计算机领域对行业的需求分析
 - (1) 计算机市场发展现状
 - (2) 集成电路在计算机领域的应用
 - (3) 计算机领域对行业需求的拉动
 - 4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析
 - (1) 消费电子市场发展现状
 - (2) 消费电子领域对行业需求的拉动
 - 4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析
 - (1) 通信设备市场发展现状
 - (2) 集成电路在通信设备领域的应用
 - (3) 通信设备领域对行业需求的拉动
 - 4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析
 - (1) 工控设备市场发展现状
 - (2) 集成电路在工控设备领域的应用
 - 1) 工业机器人
 - 2) 变频器
 - 3) 传感器
 - 4) 工控机
 - 5) 机器视觉
 - 6) 3D打印
 - 7) 运动控制器
 - (3) 工控设备领域对行业需求的拉动
 - 4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析
 - (1) 汽车电子市场发展现状
 - (2) 集成电路在汽车电子领域的应用
 - (3) 汽车电子领域对行业需求的拉动
 - 4.2.6 医疗电子领域对行业的需求分析
 - (1) 医疗器械制造业发展情况

(2) 集成电路在医疗电子领域的应用

(3) 医疗电子领域应用前景分析

第5章：集成电路封装行业市场竞争分析

5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析

5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况

5.1.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析

5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析

(1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本

(2) 主板材料的变化趋势

5.1.4 国际集成电路封装行业扶持措施借鉴

5.2 跨国企业在华市场竞争力分析

5.2.1 台湾日月光集团竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业组织构架

(3) 企业运营情况分析

(4) 企业财务情况分析

5.2.2 美国安靠（Amkor）公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业主营产品及应用领域

(3) 企业市场区域及行业地位分析

(4) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.3 台湾矽品公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业主营产品及应用领域

(4) 企业市场区域及行业地位分析

5.2.4 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业主营产品及应用领域

(4) 企业市场区域及行业地位分析

5.2.5 力成科技股份有限公司竞争力分析

- (1) 企业发展简介
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业主营产品及应用领域
- (4) 企业市场区域及行业地位分析

5.2.6 飞思卡尔公司竞争力分析

- (1) 企业发展简介
- (2) 企业主营产品及应用领域
- (3) 企业市场区域及行业地位分析
- (4) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.7 英飞凌科技公司竞争力分析

- (1) 企业发展简介
- (2) 企业主营产品及应用领域
- (3) 企业市场区域及行业地位分析
- (4) 企业在中国市场投资布局情况

5.3 集成电路封装行业国内竞争格局分析

5.3.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析

5.3.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析

5.4 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

5.4.1 现有竞争者之间的竞争

5.4.2 上游议价能力分析

5.4.3 下游议价能力分析

5.4.4 行业潜在进入者分析

5.4.5 替代品风险分析

5.4.6 行业竞争五力模型总结

第6章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析

6.1 集成电路封装企业发展总体状况分析

6.2 集成电路封装行业领先企业个案分析

6.2.1 上海华岭集成电路技术股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业运营业务情况分析
- (4) 企业技术及资质发展情况

6.2.2 山东齐芯微系统科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业股权结构分析
- (3) 企业经营状况分析
- (4) 企业产品结构分析

6.2.3 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业股权结构分析
- (3) 企业发展商业模式分析
- (4) 企业发展面临风险情况分析

6.2.4 南通华隆微电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业股权结构情况
- (3) 企业商业模式分析
- (4) 企业发展面临风险情况分析

6.2.5 上海芯哲微电子科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络

6.2.6 深圳电通纬创微电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络

6.2.7 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析

6.2.8 苏州晶方半导体科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析

6.2.9 天水华天科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析

6.2.10 南通富士通微电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析

6.2.11 苏州固锝电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业组织架构分析
- (4) 企业产品结构及新产品动向

6.2.12 星科金朋（上海）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业目标市场分析
- (4) 企业技术水平分析

6.2.13 大唐微电子技术有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络

6.2.14 矽品科技（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
- 6.2.15 安靠封装测试（上海）有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络

第7章：中国集成电路封装行业投资分析及建议

7.1 集成电路封装行业投资特性分析

7.1.1 集成电路封装行业进入壁垒

- (1) 技术壁垒
- (2) 渠道壁垒
- (3) 人才壁垒
- (4) 市场规模壁垒
- (5) 出口资质壁垒

7.1.2 集成电路封装行业盈利模式

7.1.3 集成电路封装行业盈利因素

7.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析

7.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

7.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

7.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

- (1) 通富微电公司投资兼并与重组分析
- (2) 华天科技公司投资兼并与重组分析
- (3) 长电科技公司投资兼并与重组分析

7.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

7.3 集成电路封装行业投融资分析

7.3.1 产业基金对集成电路产业的扶持分析

- (1) 基金对集成电路产业的扶持情况
- (2) 电子发展基金对集成电路产业的扶持建议
- (3) 大基金对集成电路产业的投资情况

(4) 大基金对集成电路产业的投资建议

7.3.2 集成电路封装行业融资成本分析

7.3.3 半导体行业资本支出分析

7.4 集成电路封装行业投资建议

7.4.1 集成电路封装行业投资机会分析

7.4.2 集成电路封装行业投资风险分析

7.4.3 集成电路封装行业投资建议

(1) 投资区域建议

(2) 投资产品建议

(3) 技术升级建议

部分图表目录:

图表1：封装在集成电路制造产业链中位置

图表2：集成电路封装行业产品分类

图表3：集成电路封装行业产品分类

图表4：集成电路封装产品按封装外形分类

图表5：2020-2026年江苏长电科技股份有限公司季度销售收入分布（单位：万元）

图表6：集成电路封装行业主要政策分析

图表7：2018-2024年中国国内生产总值情况及增长率（单位：亿元，%）

图表8：2018-2024年我国全部工业增加值增速（单位：亿元，%）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202005/162976.html>